

TGP 100 反应型导热脂 产品数据表

提升可靠性

高导热性能

低成本

简介

TGP 100 系列导热粘接材料是一种反应型导热硅脂，在应用时可形成极薄的键合线厚度 (BLT)，并有效消除粗糙界面处的微气泡。在设备服役过程中，该材料可逐步固化，形成具有相变导热材料性能的导热凝胶或导热垫片。TGP 100 结合了导热硅脂、导热凝胶、导热垫片及相变材料的优点，同时避免了这些传统导热材料的缺点。该产品具有较低的综合使用成本、高导热性能以及优异的可返工性，有效解决了传统导热硅脂的“泵出”问题，以及导热凝胶、导热垫片和相变材料成本高的问题。TGP 100 可作为导热界面材料，广泛应用于 LED、笔记本电脑、台式电脑及其他高功率电子设备。

物理特性

产品名称	TGP 100系列導熱膠黏劑
填充物	氮化硼 (BN)
樹脂類型	环氧树脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	2.5 – 3.5 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	20 – 50 kcp
固化材料特性	
拉伸強度 (MPa)	16
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	30
导热系数 (W/mK)	10 – 20

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm

推荐固化条件

150 °C 下固化 5 分钟。

注:5 分钟固化时间不包括粘接界面达到目标固化温度所需的升温时间。可根据实际工艺需求评估其他固化曲线。

存储及寿命

若材料保存在密封的原容器中, 並置於室溫下, 保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防潮、防蒸發並防止混入異物。蒸發和污染會對這些產品的加工性能產生不利影響。

安全

TGP 100 为环保、无毒材料。但在使用和操作过程中, 仍建议遵循一般工业卫生操作规范。如需了解更详细的安全信息, 请参阅本产品的 SDS (安全数据表)

包装

TGP 100 系列浸涂型胶粘剂提供 10 cc 及 30 cc 包装。亦可根据客户需求提供其他包装形式, 订购详情请联系 YINCAE。